

Chip-in-Polymer- eine weitere Herausforderung



Internationaler Fachkongress des Electronic Forum am 27.128. September 2001 in Waiblingen Die zunehmende Miniaturisierung, vorangetrieben vor allem durch die Entwicklung auf dem Gebiet der mobilen Telekommunikation, spielte sich in der Vergangenheit vorwiegend auf dem Board ab: auf die Verkleinerung der Bauelemente und Zunahme ihrer I/Os wurde durch verengte Leiterbahnstrukturen und die Steigerung der Lagenzahl reagiert, in der Folge verlangte die Verdrahtung neuer Gehäuseformen wie BGAs, CSPs und Flip- Chip Packages HDI-Leiterplatten mit hoher Paddichte und Microvias.

Rating: Not Rated Yet

Price

Price with discount: 1,78 €

1,78 €

Sales price without tax: 1,78 €

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)